

株主メモ

決算期

毎年3月31日

定時株主総会

毎年6月中 基準日毎年3月31日

その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。

株主名簿管理人

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱所

〒135-8722

東京都江東区佐賀一丁目17番7号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-288-324 (フリーダイヤル)

同取次所

みずほ信託銀行株式会社 全国各支店

みずほインベスターズ証券株式会社 全国各支店

株式取扱手数料名義書換

無料

新株券交付

無料

公告

当社ホームページ、または日本経済新聞に掲載します。

10BEST賞を今年も受賞！



半導体製造装置業界での唯一の顧客満足度調査であるVLSIリサーチ社による「10BEST賞」を、当社は今年も受賞いたしました。

プローバは、搬送装置部門 (Material Handling Equipment部門) で13年連続の受賞、ダイサは、組立て装置部門 (Assembly Equipment部門) で7年連続の受賞となりました。

これからも、お客様に一番ご満足いただける装置であり続けるために、世界No.1の製品をご提供してまいります。



第85期 株主通信

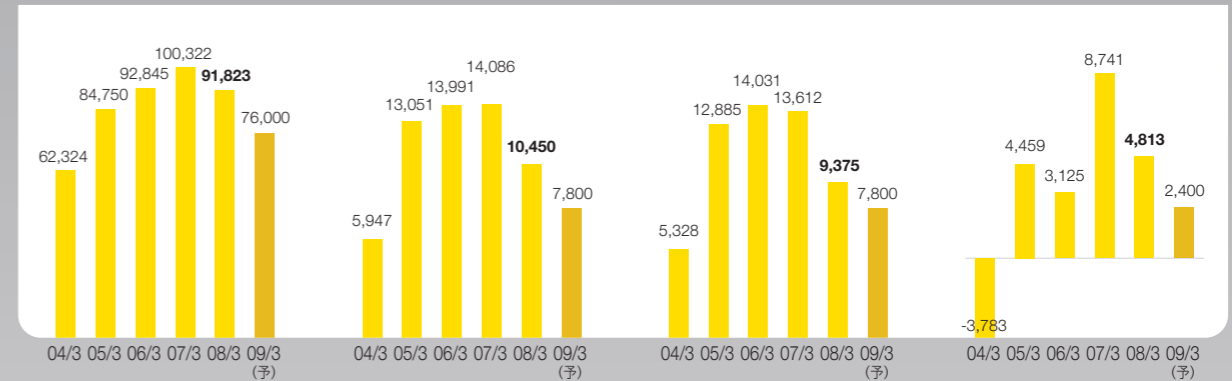
(平成19年4月1日~平成20年3月31日)

東京精密（ACCRETECH）は、計測機器および半導体製造装置のメーカーとして、お客様の生産性向上に寄与する最先端の製品開発に努めています。

当社は「WIN－WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」を行動指針にしています。当社のコア・テクノロジーを応用することと、すべてのステークホルダーと“WIN－WIN”の関係を築くことにより、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しています。

技術革新が著しい状況の中、一層の製品開発に努めるとともに、お客様のニーズに、よりマッチした製品づくりに努めてまいります。今後は現在の事業を基盤に、高成長・高収益の事業体質を作り上げ、企業価値を更に向上させていきます。

連結売上高 (百万円) 連結営業利益 (百万円) 連結経常利益 (百万円) 連結当期純利益 (百万円)



主要財務指標 (連結)

経営指標		07/3	08/3
営業利益率	%	14.0	11.4
経常利益率	%	13.6	10.2
当期純利益率	%	8.7	5.2
自己資本当期純利益率 (ROE)	%	17.3	8.8
使用総資本当期純利益率 (ROA)	%	7.8	4.3
使用総資本回転率	回	0.9	0.8
連結従業員数	人	1,235	1,318
従業員一人当たり売上高	千円	83,463	71,962
従業員一人当たり経常利益	千円	11,325	7,348
従業員一人当たり当期純利益	千円	7,272	3,773
一株当たり当期純利益 (EPS)	円	217.91	119.84
株価収益率 (PER)	倍	18.36	15.27
当座比率	%	155.7	107.7
流動比率	%	238.4	174.2
固定比率	%	52.3	54.6
固定長期適合率	%	36.1	47.9
負債比率	%	111.9	94.7
自己資本比率	%	47.1	51.2

株主の皆さまにはますますご清栄こととお慶び申し上げます。

第85期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）の株主通信をお届けする当たりまして、ご挨拶申し上げます。

当期を振り返って

まず、当期の当社を取巻く経営環境についてご説明します。半導体業界では、半導体の需給バランス悪化に伴うDRAM価格の大幅な下落などから、半導体メーカーの設備投資の抑制や繰延が相次ぎ、当社の半導体製造装置部門は非常に厳しい環境下で推移しました。一方、計測機器部門につきましては、自動車関連産業や工作機械産業を中心に各ユーザーの需要が堅調で、特に海外向けが大きく増加し、過去最高の売上高と営業利益を計上しました。

この結果、当期の受注高は819億11百万円（前期比22.3%減）、売上高は918億23百万円（同8.5%減）、営業利益は104億50百万円（同25.8%減）、経常利益は93億75百万円（同31.1%減）、当期純利益は48億13百万円（同44.9%減）となりました。

設備投資の状況

また、当社は、品質向上と生産革新を推進するために、計測（土浦工場）、半導体（八王子工

場）および東精エンジニアリングにおいて、積極的に設備投資を行っております。計測社の新工場（組立て棟）は、2008年5月に完成しました。また、半導体新工場（第5工場）は、2008年6月に着工し、2009年4月竣工予定です。また、東精エンジニアリングの新工場（北神立工場）は、2008年3月に竣工いたしました。

今後の見通し

当社は、半導体製造装置について、今期も当面厳しい環境が続くものと予想しています。しかし、当社は、リサーチ会社などの予想と同様に、2009年度（2010年3月期）以降は、力強い需要の回復があると考えております。当社は、需要の回復時に備えて、次期より顧客ニーズに合致した新製品を投入し、各製品のシェア拡大に努めていきます。また、コストリダクションや生産革新を推進し、収益性の向上を図っていく計画です。

計測機器部門につきましても、世界経済の減速が、自動車関連業界や工作機械業界に影響するものと予想されますが、シェアの低い海外向けの拡販や顧客ニーズを的確に把握し受注に繋げることで、次期についても前前期比増加すると見込んでおります。

当社の利益還元の方

当社は、半導体製造装置と計測機器において、最先端技術を駆使した世界No.1製品を提供す



代表取締役会長
鈴木 貞勝

代表取締役社長
藤森 一雄

ることにより、企業価値を高め、株主の皆様への継続的な利益還元を行うことを経営の最重要課題と考えています。

剰余金の配当につきましては、連結業績、財政状況、事業拡大のための投資および株主様の長期的視点等を考慮して決定いたします。具体的には、当社は、連結当期純利益に対する配当性向30%を目途に配当を行うとともに、一方で市況低迷時においても株主様の長期的視点を勘案し、年間配当30円を確保するよう努めております。

内部留保金につきましては、当社が成長していくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効活用してまいります。

当期の配当につきましては、中間配当として一株当たり30円を実施いたしました。期末配当

につきましては、一株当たり40円とし、一株当たり年間配当で70円といたしました。

今期の配当につきましては、市況が低迷し厳しい事業環境の中ではありますが、株主様の視点と2009年3月に創立60周年を迎えることを踏まえ、通常配当を30円、60周年の記念配当を10円とし、一株あたり年40円（うち中間配当金15円）を予定しております。

近年、企業のコーポレートガバナンスやリスク管理が従来以上に重要となっております。当社は、実効性ある内部統制システムの構築とコンプライアンス体制・リスク管理体制の確立により、コーポレートガバナンスを強化し、経営の健全性と透明性を確保していく考えです。

今後とも倍旧のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役会長 鈴木 貞勝

鈴木貞勝

代表取締役社長 藤森 一雄

藤森一雄

業績についてどのようにご覧になっていますか？

当期（2008年3月期）の業績に関しましては、減収、減益という結果になり、株主の皆様には本当に申し訳なく思っています。ただ、セグメント別に見ると、計測器事業の売上は5期連続既往ピークを更新し、営業利益も5期連続過去最高を更新しました。しかし、半導体製造装置事業に関しましては、DRAM価格の低迷等に伴い、半導体設備投資が低迷し、昨年対比減収減益となりました。この半導体設備投資の状況については、今期（2009年3月期）も急激な好転は難しいと予想しています。しかしながら、DRAM価格の回復や、業界再編の進展に伴い、今期後半には好転の兆しが見えて来て、2010年3月期以降は力強い回復があると予想しており、需要の回復時に備えた生産の効率化のために社内の体制を強化しています。

現在の当社の課題は何ですか？ またそれをどのように打開していきますか？

当社が抱える課題の一つとして、半導体事業の売上高や利益に占めるウェーハプロービングマシンの割合が非常に大きい事が挙げられます。私は、今後、ウェーハプロービングマシン、ダイサを中心とした半導体後工程製造装置、計測機器の三つの柱で東京精密を支えていくべきと考えています。これにより、市況の変化に強い事業

体質になると思います。幸いなことに計測機器は順調に拡大していますから、ダイサを中心に半導体後工程製造装置の成長を今後加速しなければなりません。

具体的にはどのような取り組みを展開されていますか？

私どもは「Win-Winの仕事で世界No.1の商品を創ろう」を行動指針にしています。実際、私どもの製品は世界No.1の製品であり、世界No.1の技術力を持っていると自負しています。ただ、これらの製品が売上高に結びつくのに非常に時間がかかっています。社長に就任してから、社内外の状況を良く調べると、技術が先行しており、必ずしもお客様のニーズに結びついていないのではないかと思います。

そこで、当期には市場のニーズを的確に捉え、製品開発に生かすマーケティング部を設立し、更にグループ毎の技術格差を埋める各グループ共通の技術部を設立しました。また今後は、八王子工場の増設により、これらのスタッフすべてをひとつのフロアに集約することで、情報交換をより迅速に行えるような体制を作り、お客様の声が製品開発時に盛り込まれるようにして行きます。

もうひとつは、派生製品の拡充を図ることです。これは、現行の製品で対応できる市場を広げていくことです。例えば、ウェーハプロービングマシンではメインの市場であるメモリー向けの市場だけでなく、その他の市場にも積極的に最適の製品を投入して行きます。ダイサでも、LED

“高い技術力を背景に、
よりお客様のニーズにマッチする
製品を市場に投入していくことが、
東京精密の今後の成長には
必要だと思います”



代表取締役社長 藤森 一雄



などの市場でももっと活躍できるはず。より幅広い市場を視野に入れ、勝てる製品を投入することが安定した成長につながるはず。

計測機器の事業は順調に推移しているようですが？

当社計測機器の主要市場である自動車業界では、品質向上に対する要求が高まっており、製品ラインのすぐ横で高精度の計測機器を使用するインライン計測への移行が進んでいます。また、自動計測の分野では、単価は大きくないものの他社にないユニークな計測機器を市場に投入しています。また、当社のシェアが低い海外市場への侵攻の余地も残っており、今後欧州の自動車市場や中国の工作機械市場などの海外市場で一層の拡販に努めていきます。特に欧州の

自動車市場に関しては、当社製品が着実に浸透してきており、成果が出始めています。

計測機器事業はこれまで順調に拡大してきました。更なる発展のためには、お客様への対応を一層強化すべきです。今期には、土浦にショールーム、トレーニングスクール、ワーク測定対応などを提供する計測センターを設置します。当社の技術をお客様の目に見える形で展示することができ、今後の拡販に貢献するものと期待しています。

計測機器の今後の課題は、自動車関連業界以外の新たな市場開発です。現在の地球環境保護の動きに合わせて、ポスト内燃機関が話題となっています。今から、計測技術が生かせる新しい分野を模索する必要があり、現在部門をあげて取り組んでいます。

原価低減活動の現状はいかがでしょうか？

原価低減は終わりのないチャレンジです。現在の課題は、製品の開発時から原価管理をきっちりやる、ということです。開発部隊だけではなく、管理部や製造のスタッフが一緒になって知恵を出し合うことで、無駄を徹底的に排除しなくてはなりません。一度、出来上がった製品の原価を下げることは大変です。さまざまな無駄も生じます。最初から、原価が低い製品を開発することが肝要です。

また、八王子工場では、ワンフロア面積が狭く、非効率であったため、工場を拡大し、生産ラインの自由度を上げます。これにより、トータ

ルな生産効率を大幅に上げることができます。これも生産コストの低減につながります。

環境保全活動における東京精密の取り組みはいかがでしょうか？

今期初の社員向けの挨拶で、私は「環境」を最優先して取り組むべき当社の課題のひとつにあげました。当然のことながら、当社の工場における消費エネルギー削減には取り組んでいますし、例年設定された環境目標をクリアし、着実に成果を残しています。

ただ、本当に地球規模での環境を考えるのであれば、当社の製品を使うお客様の現場でのエネルギー削減に貢献すべきと考えています。例えば、お客様のクリーンルームでの電力消費をどのように減らすかは大きな課題です。私たちが出来ることは、まず製品のフットプリントを小さくすることです。より狭いスペースの中で、同じ台数のウェーブロービングマシンが稼働すれば、必要とされるスペースは小さくなり、クリーンルームのランニングコストは大きく減るはず。当社が開発する全製品に対して、このような考えを徹底していきます。

グループ全体の今後の展望についてをお聞かせください。

東京精密の歴史を振り返ると、成長の第一期はエアマイクロ(空気の流量変化による測定器:

1953年に当社が日本で最初に実用品を開発)が売れ出して事業基盤ができた時代。第二期はこれまでの、半導体と計測の二つの事業基盤が出来た時代です。これからの第三期は、これらの基盤の上で、売上と収益の拡大を図っていかねばなりません。それを実現するためのキーワードは「総合力」です。営業、技術、工場で働く人間が「会社を伸ばそう」という共通の意欲を持って仕事に取り組むこと。そうすれば良い製品が生まれ、それが大きな利益をもたらすと確信しています。必ず、近いうちに結果が出ます。経営陣がやるべきことは、総合力を発揮できる仕組みづくりと、その力を発揮する方向性を示すことであり、これからも必要な手を打っていきます。



次の拡大局面に備えて、半導体製造装置事業の八王子工場と計測機器事業の土浦工場では積極的に設備投資をしています

さらなる生産効率アップを目指し、八王子工場の新棟建設がスタートしました。

また、土浦工場では、新棟が二棟完成し、既存の工場一棟を「計測センター」へとリニューアル中です。この「計測センター」は、「お客様の計測ニーズを支え、計測市場の発展に貢献する」をコンセプトに、トレーニングやセミナーが実施できるスペースも兼ね備えています。高度な技術と製品を揃え、誠意をこめたサービスでお客様にさらにご信頼いただくサービスをご提供してまいります。

半導体製造装置事業の八王子工場拡張計画



上期着工予定棟

来期以降着工予定棟

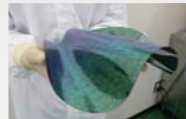
八王子完成予想図



6月初旬に行われた地鎮祭の様様



ポリッシュ・グラインダ「PG300RM」
ウェーハ薄片化とダメージ除去を一台の装置で実現することにより、搬送によるウェーハの割れ、欠けの問題を解決



プロセス後のウェーハ

計測機器事業の設備投資状況



土浦工場に新設される計測センターの完成予想図（概観・内部）



2008年3月に完成した東精エンジニアリング北神立工場



2008年5月に完成した計測社組立て棟

表面粗さ測定機「SurfcomC5」

生産現場における表面粗さ管理の自動化ソリューション



連結貸借対照表

単位：百万円

科目	第84期 (07.03.31)	第85期 (08.03.31)
流動資産	86,561	77,603
固定資産	28,270	30,063
有形固定資産	15,180	18,969
無形固定資産	3,589	3,188
投資その他の資産	9,499	7,905
資産合計	114,831	107,667
流動負債	36,312	44,540
固定負債	24,237	7,640
負債合計	60,549	52,180
株主資本	52,424	55,081
資本金	9,592	9,633
資本剰余金	20,611	20,653
利益剰余金	22,322	24,900
自己株式	△ 101	△ 105
評価・換算差額等	1,673	29
その他有価証券評価差額金	1,416	65
為替換算調整勘定	257	△ 35
新株予約権	183	375
純資産合計	54,281	55,487
負債・純資産合計	114,831	107,667

連結損益計算書

単位：百万円

科目	第84期 (06.04.01~07.03.31)	第85期 (07.04.01~08.03.31)
売上高	100,322	91,823
売上原価	72,211	67,763
売上総利益	28,111	24,060
販売費及び一般管理費	14,025	13,609
営業利益	14,086	10,450
営業外収益	208	545
営業外費用	681	1,619
経常利益	13,612	9,375
特別利益	155	7
特別損失	569	165
税金等調整前当期純利益	13,198	9,217
法人税、住民税及び事業税	4,310	2,976
法人税等調整額	146	1,427
当期純利益	8,741	4,813

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

科目	第84期 (06.04.01~07.03.31)	第85期 (07.04.01~08.03.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,920	10,014
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,439	△ 6,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,638	△ 4,815
現金及び現金同等物に係る換算差額	106	△ 26
現金及び現金同等物の増減額	2,948	△ 1,310
現金及び現金同等物の期首残高	13,851	16,800
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	175
現金及び現金同等物の期末残高	16,800	15,665

連結株主資本等変動計算書

単位：百万円

第84期 (06.04.01~07.03.31)	株主資本				株主資本 合計	評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式		その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
2006年3月31日残高	9,447	20,466	15,399	△ 90	45,223	1,340	139	1,479	—	46,703
当連結会計年度中の変動額										
新株の発行	144	144			288					288
剰余金の配当			△ 1,804		△ 1,804					△ 1,804
利益処分による役員賞与			△ 14		△ 14					△ 14
当期純利益			8,741		8,741					8,741
自己株式の取得				△ 11	△ 11					△ 11
自己株式の処分		0		0	1					1
株主資本以外の項目の変動額(純額)						75	118	193	183	377
当連結会計年度中の変動額合計	144	144	6,922	△ 10	7,201	75	118	193	183	7,578
2007年3月31日残高	9,592	20,611	22,322	△ 101	52,424	1,416	257	1,673	183	54,281
第85期 (07.04.01~08.03.31)	株主資本				株主資本 合計	評価・換算差額等			新株 予約権	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式		その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
2007年3月31日残高	9,592	20,611	22,322	△ 101	52,424	1,416	257	1,673	183	54,281
当連結会計年度中の変動額										
新株の発行	41	41			83					83
剰余金の配当			△ 2,208		△ 2,208					△ 2,208
当期純利益			4,813		4,813					4,813
自己株式の取得				△ 5	△ 5					△ 5
自己株式の処分		△ 0		0	0					0
連結子会社増加に伴う利益剰余金減少高			△ 26		△ 26					△ 26
株主資本以外の項目の変動額(純額)						△ 1,351	△ 292	△ 1,643	191	△ 1,451
当連結会計年度中の変動額合計	41	41	2,578	△ 4	2,656	△ 1,351	△ 292	△ 1,643	191	1,205
2008年3月31日残高	9,633	20,653	24,900	△ 105	55,081	65	△ 35	29	375	55,487

貸借対照表（個別決算）

単位：百万円

科目	第84期 (07.03.31)	第85期 (08.03.31)
流動資産	68,909	65,377
固定資産	28,095	25,788
有形固定資産	9,740	13,295
無形固定資産	627	627
投資その他の資産	17,726	11,865
資産合計	97,005	91,165
流動負債	31,006	41,508
固定負債	23,304	6,807
負債合計	54,310	48,315
株主資本	41,095	42,407
資本金	9,592	9,633
資本剰余金	16,966	17,007
利益剰余金	14,638	15,871
自己株式	△ 101	△ 105
評価・換算差額等	1,416	66
その他有価証券評価差額金	1,416	66
新株予約権	183	375
純資産合計	42,695	42,849
負債・純資産合計	97,005	91,165

損益計算書（個別決算）

単位：百万円

科目	第84期 (06.04.01~07.03.31)	第85期 (07.04.01~08.03.31)
売上高	86,827	78,422
売上原価	67,824	62,759
売上総利益	19,003	15,662
販売費及び一般管理費	9,438	9,701
営業利益	9,565	5,960
営業外収益	844	1,705
営業外費用	563	1,174
経常利益	9,847	6,492
特別利益	464	7
特別損失	569	1,586
税引前当期純利益	9,742	4,913
法人税、住民税及び事業税	2,609	1,141
法人税等調整額	1,466	329
当期純利益	5,666	3,442

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	
設立	1949年3月28日	
資本金	9,633,974,013円	
証券取引所	東京証券取引所 市場第一部	
会社が発行する株式の総数	110,501,100株	
発行済株式の総数	40,228,281株（うち、自己株式数29,552株）	
株主数	34,185名	
役員 (2008年6月27日現在)	代表取締役会長	鈴木 貞勝
	代表取締役社長	藤森 一雄
	代表取締役EVP兼CFO 業務会社社長	太田 邦正
	取締役	梅中 茂
	取締役	ウォルフガング ボナッツ
	取締役	吉田 均
	取締役 計測社執行役員社長	木村 龍一
	取締役 半導体社執行役員社長	高城 英明
	監査役（常勤）	久富 眞志
	監査役	川原 栄次
	監査役	高田 宥
従業員数	712名（単体） 1,318名（連結）	
主要取引銀行	みずほコーポレート銀行大手町営業部 三井住友銀行本店営業部 みずほ信託銀行本店営業部 三菱東京UFJ銀行新宿中央支社 常陽銀行土浦支店 関東つくば銀行本店営業部 りそな銀行吉祥寺支店	

事業所	業務会社 東京都三鷹市 半導体社 東京都八王子市 計測社 茨城県土浦市	
国内拠点	半導体関連営業所	4ヶ所
	計測関連営業所	20ヶ所
	グループ会社	5社 16拠点
海外拠点	北アメリカ	9ヶ所
	ヨーロッパ	4ヶ所
	アジア	15ヶ所

株式の状況

株主名	持株数（千株）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	5,146
野村信託銀行株式会社（投信口）	1,368
財団法人精密測定技術振興財団	1,058
株式会社みずほコーポレート銀行	840
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	801

所有者別状況

(株式数比率)

